平伟实业智能化生产车间 摄/刘辉

亿联智能家居生产现场 摄/肖华

仟和镁业的新能源汽车镁合金新材料生产车间 摄/焦伟

上口佳农业开发有限公司智能化生产线 摄/刘辉

优化创新环境 提升创新能力 发展高新产业

梁平 创建国家高新区 推动高质量发展

党的十九大以来，梁平区聚焦“高质量、供给侧、智能化”，在优化创新环境、提升创新能力、发展高新产业等方面狠下功夫，大力实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，加快发展电子信息、智能家居、绿色食品加工三大主导产业，培育壮大集成电路、新材料、通用航空三大战略性新兴产业，全力打造绿色制造业基地、消费品工业基地。市级高新区创建通过评审，接续创建国家高新区，打造推动渝东北三峡库区践行高质量发展的重要承载地、生态优先当示范、绿色发展当标杆。

创建中的梁平高新区 摄/苟琴

梁平已开展飞行培训、空中观光等通用航空业务

巨源不锈钢冷轧线正在生产高端不锈钢新材料 摄/张常伟

创建工作高位推进

梁平位于渝东平原核心区域，是巴渝第一大平坝，处在全市“一区两群”和川东北的重要联结点上，是主城都市区东向开放的重要支点，是大三峡绿色发展的纵深地带，是深化川渝东北合作的天然桥头堡。

2019年1月，全区召开创建高新技术产业开发区动员大会，全面启动创建工作，编制完成了高新区产业发展规划及集成电路、智能家居、绿色食品加工三大产业集群发展专项规划和现代服务业发展规划，对照高新区创建的五个方面23项指标印发了《创建工作方案》，分解落实到责任单位，加快发展高科技、培育新产业，做实做好“高”和“新”两篇文章。

两年来，对照《重庆市市级高新技术产业开发区认定和管理办法》，全区上下合力攻坚，重点紧盯600亿元产值、60家高企、60个专业研发机构和科技服务机构等核心指标及重要创新创业平台建设，加强与高等院校、科研院所合作，强化引资引智，建立“四会三报”（即周例会、月调度会、推进会、专题会，周简报、月通报、专报）等工作推进机制，安排落实高新区创新创业平台、基础设施及重大项目建设等资金近30亿元。

目前，梁平工业园区建成面积达20平方公里，累计入驻企业470家，规上企业达到88家。全区国家高新技术企业累计达64家，市级数字化车间累计达9家，科技研发机构和科技服务机构分别达到36个、40个。建成并运营重庆都梁科技企业孵化器、高新区规划展览馆，加快建设科创中心等创新创业服务平台。2020年11月，市级高新区顺利通过专家组评审论证和市级相关部门联合审定，成为“两群”地区第一个市级高新区。预计2020年地区生产总值近500亿元，人均GDP继续保持渝东北渝东南前列，规上工业增加值达170亿元。

在我国转向高质量发展阶段，推进形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展新格局中，市委、市政府赋予梁平“发挥联接主城都市区作用”“积极承接沿海地区和主城都市区的产业转移，吸纳生态功能区的人口转移”“打造重要的先进制造业基地和消费品工业基地”等新的功能定位，梁平区从全局谋划一域、以一域服务全局，抢抓发展机遇，“以开促建”，乘势而上创建国家高新区，全面融入成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”协调发展。

创新生态持续优化

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。梁平区始终把营造良好创新创业生态环境作为创建高新区的坚实保障，持续推动创新创业氛围营造，加强创新创业服务保障，先后研究出台《关于全力攻坚突破一批重大改革项目的工作方案》等改革文件，修订完善《创新驱动奖扶办法》《专利资助奖励办法》《“四上”企业奖励扶持办法》等系列政策，制定《2020“营商环境建设年”行动方案》，着力构建“亲清”政商关系，为推进大众创业、万众创新奠定坚实基础。

重庆融康彩印包装有限公司是一家集研发、生产和销售为一体的纸箱、彩箱、塑料包装企业，在梁平区380万元知识价值信用贷款支持下，实现浸蜡纸箱工艺、吸塑工艺等自动化技术研发和产业化，纸箱防水防震抗变形方面的技术研发取得重大突破，填补了国内轻质重承纸品的技术空白。目前，研发并申请专利30多个（其中发明专利7个），获批国家高新技术企业。

同样，重庆天胜电子有限公司在360万元知识价值信用贷款的支持下，开展新产品研发和智能化改造，新申请1件发明专利和2件实用新型专利。通过新产品的开发，在去年疫情期间，企业产品市场出现正增长，预计全年销售总产值将增长35%以上。

创新生态激发了创新创业激情，有力促进了企业加大研发投入、引进培育科技人才、构建研发机构、加快科技成果转化和产业化，实现创新发展、可持续发展。为深化科技体制改革，推进科技金融改革创新，建立健全科技型企业轻资产融资模式，梁平区与重庆市科技局联合组建了1亿元科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，两年来累计为81家科技型企业发放知识价值信用贷款1.26亿元，引导叠加商业贷款0.68亿元；联合组建2000万元区种子基金，已为40家初创和小微科技型企业提供免息信用贷款1800万元。及时落实兑现各项惠企政策，累计减税降费近5亿元；强化创新奖扶政策的落实，年兑现创新奖扶资金1000万元以上。支持国有企业参股民营高科技企业发展战略性新兴产业，工业园区公司投资2亿元参股平伟实业实施5G射频模组与器件产业化项目。

2020年5月，梁平区首个智能化、规模化科技服务综合体——高新区科创中心（一期工程）开工建设。该工程是梁平高新区配套设施建设项目之一，建设内容包括高新产品展示中心、科技企业孵化中心、企业服务中心。目前，科创中心（一期）工程完成80%，今年5月底建成投用后，将提升区域科技创新水平和科技服务能力，引进高等院校、科研机构的科技成果在梁转移转化，加快培育科技型企业特别是高新技术企业。

梁平持续推进财政科技投入、科研管理、人才引进、产权激励、金融服务、土地资源配置等改革创新。2019年以来，全区在高新区创建过程中，实施基础设施项目68个，园区道路、人才公寓、科创中心、孵化器、公租房、中小学及职教学校、医院、公园、车站、商圈等一批基础配套设施逐步完善，智慧园区、绿色园区、绿色工厂建设深入推进，推进人产城景深度融合、一体化发展。

创新能力持续提升

科技创新是产业发展的重要推动力，而高新技术企业是创新驱动发展和经济高质量发展的主力军。梁平区始终把提升科技创新能力作为创建高新区的重要标准，坚持上下联动、部门协同、加大投入，大力推进大数据智能化创新，聚资源、强技术、壮主体、育人才、优环境，持续推动关键核心技术攻关、科技成果转化，切实增强创新发展的内生动力。

2020年上半年，重庆市汇森玩具有限公司受疫情影响，生产经营曾一度陷入困境。而到当年11月，公司产值近4000万元，与上年同期相比基本持平。总经理蒋礼燕介绍，“汇森玩具的秘诀就是创新。”2019年，公司生产的玩具种类不足5000种，公司将产品创新作为企业核心竞争力，去年一年研发出超过5000种新玩具，不仅稳住了“基本盘”，还新增了3个国外客户、2个国内客户，“从制造精品到创造新品，创新让我们具备了更强的竞争优势。”

豆棒是中国豆制品中制作工艺最复杂的传统食品之一，产能较低、人工成本较高。2016年，陈永晶、王磊等人成立重庆两颗豆农业科技发展有限公司，研发智能化设备全自动化数控豆筋机，让豆棒生产从小作坊走上了“自动化、智能化、规模化、标准化”生产道路，“两颗豆”因此成为中国豆棒行业智能化领跑者。目前，公司拥有20余项发明专利、100余项实用新型专利，建成第五代数字化豆棒生产车间。

“我们加快创新人才的引育和科技型企业培育库建设，大力实施科技型企业梯次培育计划和倍增计划，加快形成科技型中小企业铺天盖地、高新技术企业顶天立地的发展格局。”梁平区相关负责人介绍，梁平区出台《梁平区科教兴区和人才强区行动计划（2018–2020）》（梁平区引进高层次人才若干优惠政策规定）《高企引育认定专项资金管理办法》，建立“科技引资引智”专业团队，与市内外23所高校、科研院所开展合作，柔性引进“两院”院士3名、高层次人才72人次，深入推进协同创新。“十三五”以来，入库重庆市科技型企业从“零”发展到203家、国家科技型企业从“零”发展到42家，国家高新技术企业由2家发展到64家。科技型企业在重庆OTC挂牌9家。重庆平伟实业股份有限公司被认定为“国家火炬计划”重点高新技术企业。

“高新区是科技的集聚地，也是创新的孵化器，科技平台加速构建。”梁平区科技局相关负责人介绍，梁平区力推进科技开放合作，推动各类创新主体功能互补、良性互动，正加快推进集成电路、新材料、绿色食品等产业技术创新公共服务平台建设。大力引进和建设一批众创空间、科技企业孵化器等专业科技服务机构，积极构建“政府出资+市场运作”的科技服务网络体系。推进科技成果转化，创新驱动正不断释放出强劲动能。科技创新创业平台从“零”发展到各类专业研发机构36个、科技服务机构41个、法人化研发机构6个、星创天地4个、科普基地4个、专家大院4个，孵化服务总面积近30万平方米。累计承担“863”计划等国家及市级重大专项、重点研发项目27项，有效专利1754个，每万名从业人员拥有发明专利数达到25件，获得市政府科技进步一、二等奖各2项，高新技术产品129个，创新成果加快转化，新产品销售收入占产品销售收入总额比重达到35%，战略性新兴产业产值占工业总产值比重达到20%。新产品销售收入占产品销售收入总额比重达到35%。

高新产业加速发展

1月初，重庆平伟实业股份有限公司（下称“平伟实业”）5G射频模组及器件产业化项目（下称“5G射频项目”）厂房主体建筑完工，今年6月将正式投产。

过去，平伟实业是一家简单的二极管生产企业。2007年，平伟实业落户梁平后，每年拿出销售收入的10%用于研发。如今，平伟实业已成长为国家高新技术企业、国家星火计划重点高新技术企业，带动了梁平电子信息产业从无到有、快速发展，梁平因此被认定为“国家功率半导体封测高新技术产业化基地”。

5G射频项目落户，促进梁平进一步扩大科技和产业的对外开放合作，引进集成电路高端人才和先进技术，推动集成电路产业走向高端化，助力梁平战略性新兴产业发展迈上新台阶。

“大力推进数字产业化、产业数字化，持续发展创新产业。”梁平高新区负责人介绍，梁平区始终把促进产业创新发展作为创建高新区的基本内涵，大力实施大数据智能化科技创新，加快电子信息、智能家居、绿色食品产业转型升级，让“老树发新芽”；培育壮大集成电路、新材料、通用航空战略性新兴产业，发展现代服务业，让“新芽成大树”，打造绿色制造业基地和消费品工业基地。全力发展高新产业，加快构建现代产业体系。

集聚壮大集成电路产业，梁平区紧扣重庆市培育“芯屏器核网”全产业链、建设“云联数算用”要素集群，以平伟实业为龙头，以国家功率半导体封测与应用高新技术产业化基地为依托，突出集成电路封装测试特色，加快聚集产业链上下游企业，推进平伟实业5G射频模组产业化和第三代碳化硅半导体设计封测、济南兰星电子GPP芯片制造、捷尔士显示等重大项目顺利落地建设，做优做强国家功率半导体封测高新技术产业化基地。

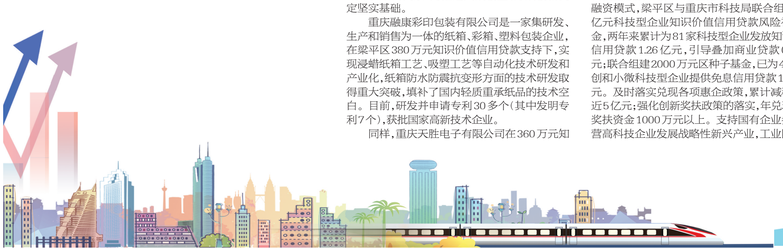
提质发展新材料产业，梁平区以仟和镁业、巨源不锈钢和竹基新材料产业园为依托，推进新能源汽车镁合金新材料、医用及食用级不锈钢新材料、竹基新材料等重大项目顺利落地建设，加快培育绿色新材料产业集群。

通用航空以梁平民两用通航机场为依托，发挥独特的空域条件，建设通用航空产业园，大力打造通航货运枢纽机场、无人机研发制造、机务地勤培训基地。目前，已有长安工业、芸中鹰、九洲神鹰、龙浩航校、顺丰蜂鸟等通航企业入驻。

党的十九大以来，重庆上口佳农业开发有限公司大力开展“机器换人”行动，2018年至今累计投入2000万元以实施智能化改造，生产自动智能化程度达70%以上。

“提高了功效、增加了效益，助推企业高质量发展。”梁平区相关负责人表示，围绕“互联网+”发展战略，成功培育了平伟实业、天胜电子、奇爽食品、百年张鸭子、上口佳等企业数字化车间9家、智能工厂1家。推进数字产业化、产业数字化，促进产业转型升级。

目前，梁平区坚持以提高自主创新能力和战略科技力量为主攻方向，以科技自立自强为战略核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，进一步优化创新生态、夯实创新基础，强化建载体、育主体，促转化、推改革，发展新技术、培育新产业，聚力创建国家高新区，推动高质量发展。



梁平科技企业孵化园。摄/陈琴平

赵童 王琳琳 王今
图片除署名外由梁平区委宣传部提供